

機台名稱：	W2W 晶圓對準接合機
機台編號：	SE-025
制訂部門：	異質整合製程組
制訂日期：	2021/10/15

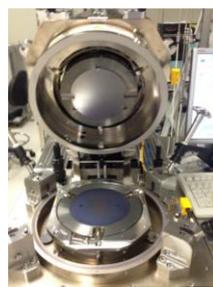
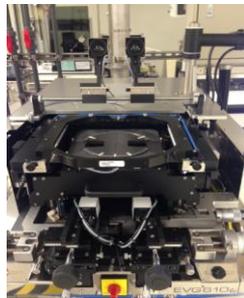
一、目的： 定義 W2W 晶圓對準接合機操作規範，以確保操作品質。

二、範圍： 適用於 W2W 晶圓對準接合機。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。

2. 執行人員資格：經過 W2W 晶圓對準接合機考核通過之人員。



四、名詞定義：無。

五、標準作業程序：

(一)操作流程:

1. 機台刷卡開機登入。
2. 確認製程程式已開啟。
3. 於對準機上按照提示步驟 step by step 進行上下晶圓對準後,完成夾置於 bond chuck 上之作業。
4. 將 bond chuck 小心取起翻轉後置放於晶圓接合機上。
5. 蓋上腔體上蓋後確實鎖緊後，點選欲執行之 recipe 後點選 Done。
6. 製程結束後，將腔體上蓋開啟後，將 bond chuck 小心取起後並將試片取出。
7. 機台刷卡登出

(二)注意事項:

1. 試片背面須確實擦拭平整，避免拓印到 bond chuck 上。
 2. 只能進行完整 6&8 吋晶圓，無法進行其他尺寸試片製程。
-